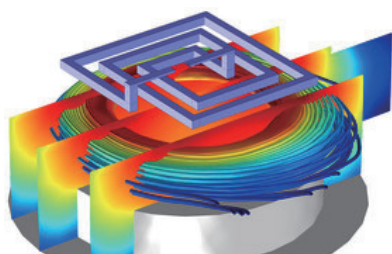


第84回応用物理学会秋季学術講演会 ランチョンセミナーのご案内

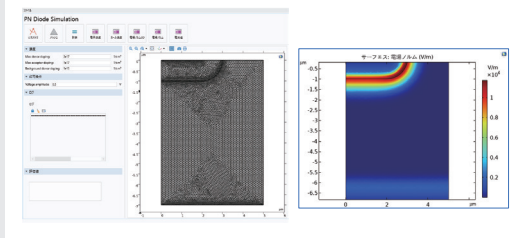
COMSOL Multiphysics® による 半導体向け適用事例と その教育用アプリケーションの開発

3D ICP 反応器 (アルゴン化学)



半導体製造プロセスは様々な工程があり、各々のプロセスにあった物理現象を解く必要があります。COMSOL Multiphysics® は様々な物理現象を複合的に解けるシミュレーションソフトですので、半導体製造プロセスの様々な工程にあわせてシミュレーションを行う事ができ、現象の可視化による根拠に基づいた設計にお役立頂けます。

教育用アプリケーションの開発



本公演では COMSOL Multiphysics® による半導体関連の適用事例をご紹介します、また、COMSOL Multiphysics® のアプリ作成および配布によって、半導体人材育成への展開を模索した事例を紹介します。

日時 9月20日(水) 12:10~12:50

会場 A303

定員 50名(先着)

申込 学会 WEB サイトにて事前申し込み
※残席がある場合、当日会場にて参加受付

お問い合わせ

COMSOL Multiphysics® 日本総代理店

KESCO KEISOKU ENGINEERING SYSTEM
計測エンジニアリングシステム株式会社

TEL : 03-6273-7505

E-mail : marketing@kesco.co.jp

<https://kesco.co.jp/>

